

DETERGENTI VOC FREE

T-CLEAN

Il **T-CLEAN** è un detergente a base acqua appositamente studiato per la rimozione di residui di pasta saldante e colle da telai serigrafici, lamine, misprints e accessori per la serigrafia.

Può essere impiegato sia per un'utilizzo manuale che direttamente nelle macchine automatiche (a spray e ad ultrasuoni) per la pulizia dei telai.

Il prodotto **T-CLEAN** raggiunge la massima efficienza di utilizzo ad una temperatura compresa tra 24° e 28°.

DATI TECNICI:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| PH A 20°C | neutro |
| TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE | >100 °C |
| RISCHI DI ESPLOSIONE | nessuno |
| TEMPERATURA DI UTILIZZO | 22-30 °C |
| APPLICAZIONE | puro |
| STOCCAGGIO | in tanica originale |
| CONTENUTO DI SOLVENTI VOC | <10% |

APPLICAZIONE:

| | |
|--------------------------|----------|
| RIMOZIONE COLLA SMD | discreta |
| RIMOZIONE PASTA SALDANTE | ottima |



T-CLEAN PLUS

Il **T-CLEAN PLUS** è un detergente a base acqua appositamente studiato per la rimozione di residui di pasta saldante e colle da telai serigrafici, lamine, misprints e accessori per la serigrafia.

Può essere impiegato sia per un'utilizzo manuale che direttamente nelle macchine automatiche (a spray e ad ultrasuoni) per la pulizia dei telai.

Il prodotto **T-CLEAN PLUS** raggiunge la massima efficienza di utilizzo ad una temperatura compresa tra 24° e 28°.

DATI TECNICI:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| PH A 20°C | neutro |
| TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE | >100 °C |
| RISCHI DI ESPLOSIONE | nessuno |
| TEMPERATURA DI UTILIZZO | 22-30 °C |
| APPLICAZIONE | puro |
| STOCCAGGIO | in tanica originale |
| CONTENUTO DI SOLVENTI VOC | <10% |

APPLICAZIONE:

| | |
|--------------------------|--------|
| RIMOZIONE COLLA SMD | ottima |
| RIMOZIONE PASTA SALDANTE | ottima |

